

京鼎精密科技股份有限公司

2025第二季法人說明會

2025/09/24

免責聲明



- ■本簡報及同時發佈之相關訊息內,含有從公司內部與外部來源所取得的預測 性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異,其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- ■本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。

會議議程



■公司簡介

■財務報告

■營運與展望

■問答交流

李貞誼發言人鍾曉佩副處長

鄒永芳財務長李貞誼發言人徐朝煌協理黃俊凱個處長

3

公司簡介





主要業務

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體設備及零部件再生循環
- 半導體自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療設備製造及設計服務



2015 2001 成立 上市(3413TT)

截至2025/8/29

3,828 員工人數

NT\$ 10.80億 股本

截至2025/6/30

NT\$ 313.27億 市值

截至2025/08/29

2025年上半年毛利 2025年上半年營收

NT\$26.88億

NT\$ 10.11元

2025年上半年每股盈餘

+43.0% YoY

NT\$100.72億

+47.1% YoY

-17.7% YoY

全球佈局



生產基地:橫跨 4 區 7 廠,羅勇廠 Q1 啟用,春武里廠 Q3 完工

竹南科中廠(HQ)





BKK國際機場

9 13"31"30.2" N 101"04'03 9 F

春武里廠



新產品開發中心

美國矽谷廠















- ●: 營運製造據點-台灣-竹南/上海/江蘇
- ●:營運製造據點(新增)-泰國
- ●:新產品導入與小量生產據點-矽谷,USA
- ●: 銷售服務與國際採購據點-台灣/江蘇/加州/德州/ 亞利桑那州



綜合損益表



單位:新台幣百萬元	2Q25	1Q25		QoQ%	2024		YoY%	1H25		1H24		YoY%
營業收入淨額	5,203 100.0	6 4,869 1	100.0%	6.8%	3,721	100.0%	39.8%	10,072	100.0%	7,043	100.0%	43.0%
營業毛利	1,358 26.19	1,330	27.3%	-1.2 ppts	992	26.7%	-0.6 ppts	2,688	26.7%	1,827	25.9%	+0.8 ppts
營業費用	(481) (9.2%	(453) ((9.3%)		(386)	(10.4%)		(934)	(9.3%)	(739)	(10.5%)	
營業利益	877 16.99	877	18.0%	-1.1 ppts	606	16.3%	+0.6 ppts	1,754	17.4%	1,088	15.4%	+2.0 ppts
營業外損益	(456) (8.8%) 83	1.7%		141	3.8%		(372)	(3.7%)	404	5.7%	
稅前淨利	421 8.1%	960	19.7%	-11.6 ppts	747	20.1%	-12.0 ppts	1,381	13.7%	1,492	21.1%	-7.4 ppts
本期淨利	391 7.5%	724	14.9%	-7.4 ppts	696	18.7%	-11.2 ppts	1,115	11.1%	1,242	17.6%	-6.5 ppts
歸屬予:												
母公司股東	369	724		49.1%	69	96	-47.1%	1,0	93	1,2	42	-12.0%
基本每股盈餘(元)	3.41	6.71	ı	(3.30)	6.	75	(3.34)	10	.11	12	.29	(2.18)
加權平均流通在外股數(百萬股)	108.17	107.9)1		103.09		103.09 108.04		3.04	101	1.00	

資產負債表及重要財務指標



		-	/>		_		_
單1		* T	=	PECK.	_		
_	ш.	4441				pag.	,,

現金及流動金融資產

應收帳款

存貨

長期投資

不動產、廠房及設備

無形資產

資產總計

應付帳款

銀行借款

應付公司債

流動負債

負債總計

股東權益總計

重要財務指標

平均收現天數

平均銷貨天數

平均付現天數

淨營運現金週期天數

流動比率(倍)

2Q25						
7,576	29%					
1,815	7%					
3,904	15%					
438	2%					
8,016	31%					
2,425	9%					
26,062	100%					
1,359	5%					
2,829	11%					
222	1%					
7,311	28%					
10,077	39%					
15,985	61%					

1Q2	.5	2Q2	4
9,760	41%	11,169	53%
1,840	8%	1,472	7%
4,032	17%	2,984	14%
528	2%	396	2%
5,891	25%	4,013	19%
35	0%	33	0%
23,575	100%	21,254	100%
1,521	6%	1,272	6%
1,653	7%	1,824	9%
301	1%	836	4%
6,628	28%	5,233	25%
8,898	38%	8,314	39%
14,677	62%	12,940	61%

32	
99	
38	
93	
1.88	

33	29
105	10
42	39
96	92
2.41	3.0

現金流量表



單位:新台幣百萬元	1H25	1H24	
期初現金	7,527	6,956	
營運活動之現金流入	414	691	
資本支出	(2,119)	(437)	
定期存款	276	50	
銀行借款淨變動	908	153	
企業合併現金淨支付數	(1,263)	-	
投資與其他	(65)	158	
期末現金	5,678	7,571	
自由現金流量*	(1,705)	254	

^{*}自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出



營運與展望

營收趨勢

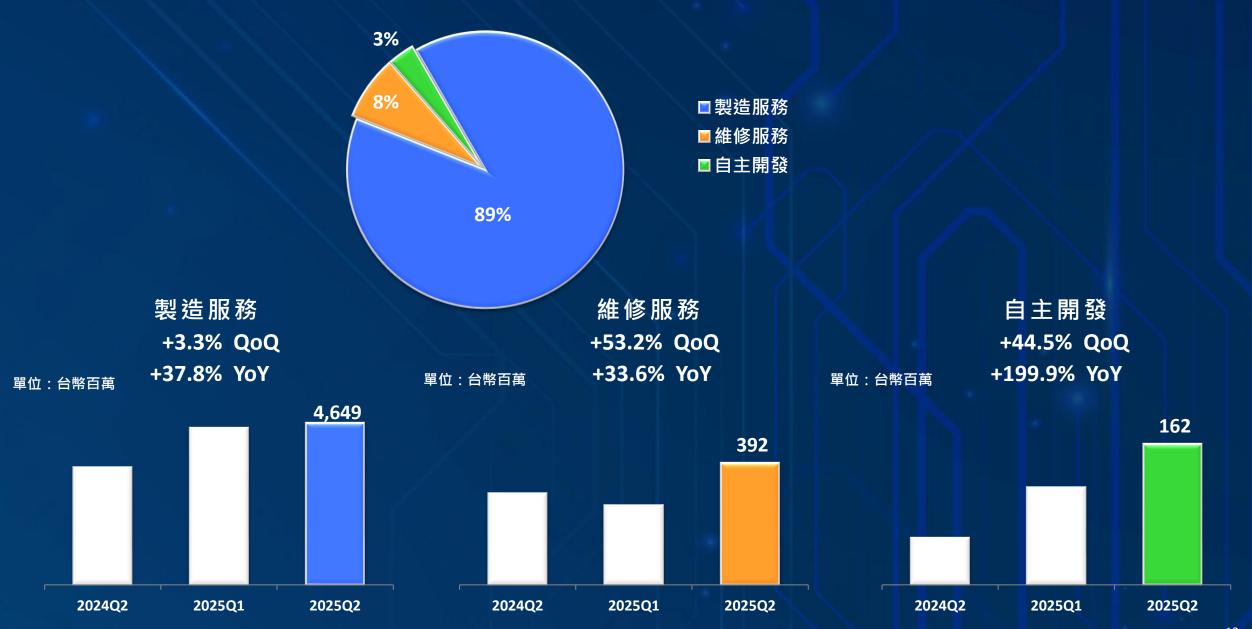


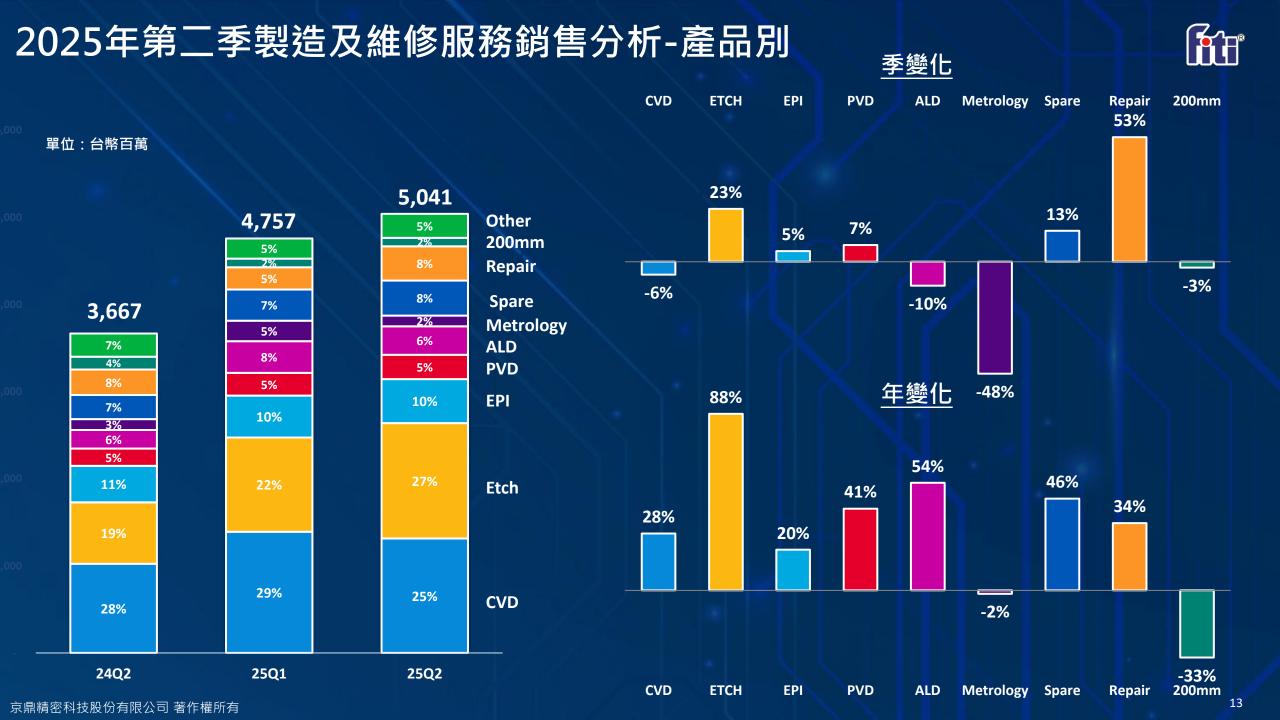


註:製造服務=半導體製程設備關鍵模組、零部件與備品耗材製造 維修服務=半導體與航太維修 自主開發=半導體自動化設備

2025年第二季銷售分析-業務別







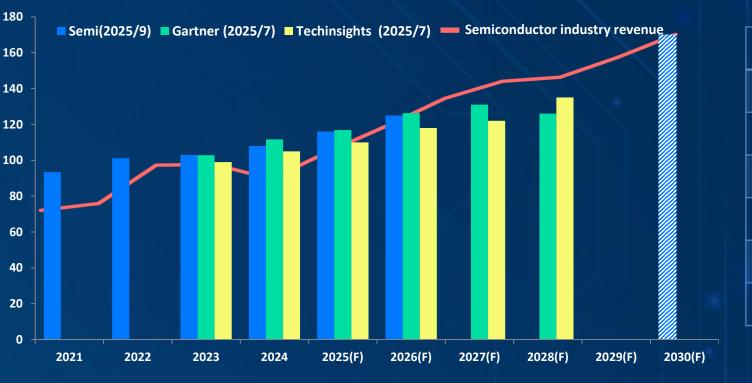
產業趨勢

US\$ Billion



- 2025 年 WFE 市場預期成長 5%-7%: AI 與 HPC 應用推動先進邏輯、高階記憶體與先進封裝需求,惟中國投資放緩,以及車用、工業與消費電子需求疲弱,抵銷部分成長動能。
- 2026 年 WFE 市場預估成長 7%-8%:主要設備商短期能見度受到總體經濟、地緣政治及關稅不確定性影響而下降,惟 AI 應用深化、 先進節點推進與製程複雜化,支撐半導體設備市場展望持續正向。
- ■長期展望:AI 應用深化、先進製程持續演進,加上地緣政治推動區域擴廠與供應鏈在地化,成為半導體設備產業發展的長期驅動力。





WFE(\$B)	2024	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)
Semi (2025/9)	108	116	125		
YoY	5%	7%	8%		
Gartner (2025/7)	112	117	126	131	126
YoY	9%	5%	8%	4%	-4%
TechInsights (2025/7)	105	110	118	122	135
YoY	6%	5%	7%	3%	11%

Source:Semi/Gartner/TechInsights

2025年第三季展望





QoQ

YoY



製造服務

QoQ



YoY



維修服務

QoQ

YoY



自主開發



QoQ



YoY



獲獎榮耀





中華徵信所台灣地區大型企業排名 TOP 5000

一 公民營企業混合排名:第387名

一 製造業經營績效排名:第 25 名

- 專用生產機業 :第 4 名



台灣董事學會外資精選台灣 100強企業

一 外資精選台灣企業100強:第59名

總結



■ 營運成果

- > Q2 營收創單季新高,上半年營收突破百億元,再創同期高點;惟匯兌損失影響 EPS 表現
- 因應地緣政治,公司加速泰國產能布局。羅勇廠產能穩步提升,春武里廠完成建廠並進入認證, 預計於今年 11 月舉辦開幕儀式,2026 年起將貢獻營運
- ➤ 通過 ISO 13485 認證,醫材製造能力符合國際規範

■ 營運展望

- 8月營收18.2億元創歷史新高,累計前8個月營收亦創同期新高。受檢測新案出貨、子公司富蘭 登營收挹注,以及備品維修與自主開發業務成長帶動,下半年營運可望持平或略優,關稅與匯率 變化仍需持續關注
- WFE 市場短期因地緣政治與關稅不確定性影響,能見度下降;然而在 AI 應用深化、先進製程演進與供應鏈在地化推動下,市場預期 2025-2027 年仍將維持穩定成長
- 地緣政治與供應鏈自主驅動台、韓、美、日設備支出增加,抵銷中國下滑,區域分布更趨平衡

17



